

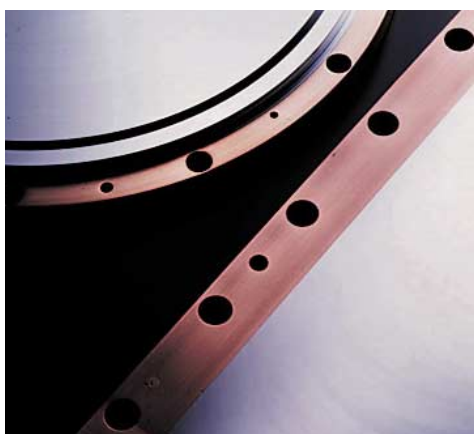
Electronics

永年培った独自のデータと技術で、ターゲット及びボンディングの高品質化・低コスト化を実現。

Kyodo International has developed a high-quality, low-cost target bonding process based on years of experience in fabricating thin film products.



BONDING PROCESS



私たちは、各種スパッタリングターゲット材の取扱いからスタートしました。以来、今日まで材料販売を通して蓄積した膨大な基礎データに加え、独自に開発した接合技術や用途に合った最適な溶剤選択技術、さらに塗り込みを強固にする為の超音波ウェルダなどの採用により、他社にはない大型サイズのボンディングを実現しました。冷却効率の均一化や割れに対する防止策など高品質のボンディングにお応えしています。

さらに、システム化された作業プログラムにより、バックングプレートを再生し、各種スパッタリングターゲット材を提供するために、ボンディングの低コスト化と納期の短縮化を同時に実現するなど、ユーザー固有のさまざまなニーズに対して、迅速かつキメ細かな対応でお応えしています。



We started this part of our business from using a variety of target materials used in our in-house thin film contract services operation. We have developed large-scale bonding capability through a huge database of engineering experience in; optimal solder processing, ultrasonic welding, and quality control methods that ensure the highest quality bond free of defects. In addition, We offer recycle programs for the backing plates and a variety of sputtering target materials. Our systematized programs have demonstrated low-cost bonding and improved delivery times while remaining flexible to special requirements.

